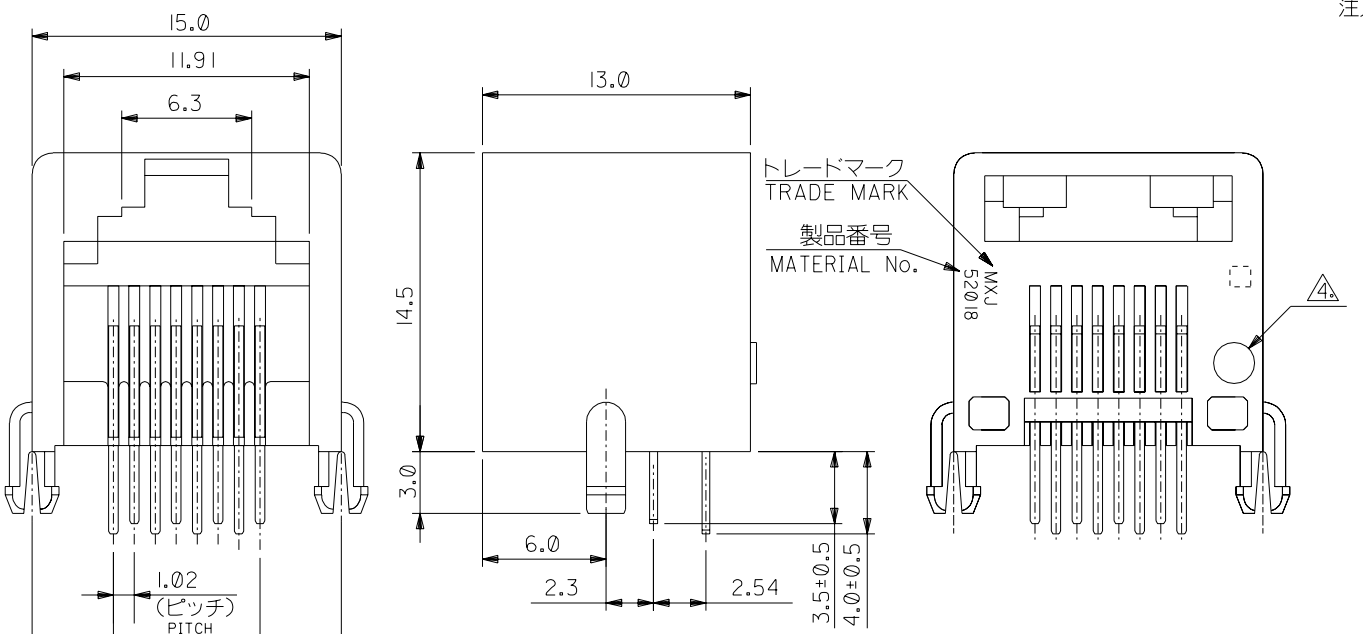
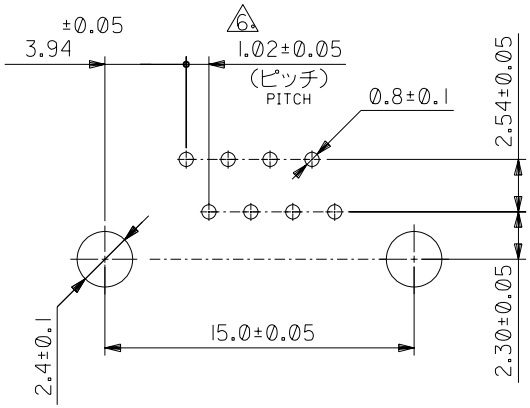


注）NOTES

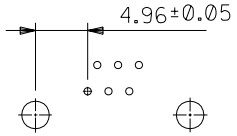
1. 材質 MATERIAL
   ハウジング：ガラス入リポリエステル UL94V−0
   HSG. :POLYESTER G.F.15% UL94V-0
   ターミナル：リン青銅
   TERM.:PHOSPHOR BRONZE
2. メッキ仕様 PLATING
   接点部 ：金メッキ、表参照
   CONTACT AREA: GOLD PER TABLE
   半田付け部：錫メッキ 1.0μmMIN.
   SOLDER AREA : TIN 1.0 μm MIN.
   下地メッキ：ニッケルメッキ 1.0μmMIN.
   UNDERPLATE : NICKEL 1.0μmMIN.
3. 推奨基板厚：t＝1.6±0.05
   RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05

4. 金メッキ厚標示
   COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING
   黄色：0.1μmMIN. 緑色：0.38μmMIN.
   YELLOW : 0.1 μmMIN. GREEN : 0.38 μmMIN.
   オレンジ色：0.76μmMIN. 無色：1.27μmMIN.
   ORANGE : 0.76 μmMIN. UNMARKED: 1.27 μmMIN.
5. ハウジングの色は、グレイ。
   HOUSING COLOR IS GRAY.

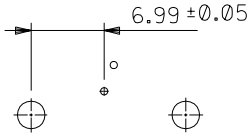
6. 公差非累積。
   NON-ACCUMULATIVE
7. 本製品は 52018-8**5 の鉛フリー品である。
   THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52018-8**5.



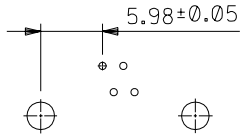
後番号 −88＊6に適用
MATERIAL NO. SUFFIX -88*6



後番号 −86＊6に適用
MATERIAL NO. SUFFIX -86*6



後番号 −82＊6に適用
MATERIAL NO. SUFFIX -82*6



後番号 −84＊6に適用
MATERIAL NO. SUFFIX -84*6

基板穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
(ジャック取付け側)
(JACK ASS'Y SIDE)

52018-8**6 MODEL NO.	ポジション POSITION	極数 CIRCUITS	(A)	金メッキ厚(μmMIN.) GOLD PLATING THK(MIN.)(μmMIN.)	製品番号 MATERIAL No.
8	8	8	7.11	1.27	52018-8846
				0.76	-8836
				0.38	-8826
				0.1	-8816
		6	5.08	1.27	-8646
		4	3.05	1.27	-8446
		2	1.02	1.27	52018-8246

角度 ANGLE	±3°				
30以上 OVER	±0.3				
10以上 30未満 OVER UNDER	±0.25	0	新規作成 RELEASED (J2004-4035)	M.N M.S	04/04/28
10未満 UNDER	±0.2	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
一般公差 GENERAL TOLERANCES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			

材料 MATERIAL: 注参照 SEE NOTES
仕上げ FINISH: 注及び表参照 SEE NOTES AND CHART
適用電線範囲 WIRE RANGE: —#—
被覆外径 INS. RANGE: —#—
DRAWN BY '04/04/28 M.NABEI
CHK'D BY '04/04/28 K.TOJO
APP'D BY '04/04/28 M.SASAO
尺度 SCALE 4 - 1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

EDP. NO. —#—
ENG. NO. SD-52018-001
REV 0
TITLE 名称
MODULAR JACK
HOUSING ASS'Y -LEAD FREE-

ENG. NO SD-52018-001
EDP NO. —#—
:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING
SD-52018-001.S01

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。